

## Eigenschaften

# FK 1071

## AgPt-Leitpaste für AlN-Substrate

### Typische Schichteigenschaften<sup>1</sup>

Schwindung <sup>2</sup> (%)	43 -47		
Gebrannte Schichtdicke (µm)	14 –16		
Flächenwiderstand <sup>3</sup> (mOhm/sq)	< 6		
Lötbarkeit <sup>4</sup> Sn/Pb/Ag 63/35,5/1,5	> 98		
Ablegierfestigkeit <sup>5</sup>	3 - 4 dips		
Haftfestigkeit <sup>4,6</sup> Initial Gealtert 100 h, 150°C	1 x gebrannt	3 x gebrannt	1 x gebrannt <sup>7</sup>
	> 16 N/4mm <sup>2</sup>	> 15 N/4mm <sup>2</sup>	> 12 N/4mm <sup>2</sup>
	> 16 N/4mm <sup>2</sup>	unzureichend	unzureichend

#### Bemerkungen:

<sup>1</sup> Profil: 850°C, 10 min, 60 min Zykluszeit

<sup>3</sup> Gebrannte Schichtdicke: 15µm

<sup>5</sup> Flußmittel: Alpha 611, 230°C, 5 s

<sup>7</sup> Profil: 850°C, 10 min, 30 min Zykluszeit

<sup>2</sup> (1- gebrannte Schichtdicke/Getrocknete Schichtdicke)

<sup>4</sup> Flußmittel: Alpha 611, 220°C, 5 s

<sup>6</sup> 90 ° wire-peel-test, 2mm x 2mm, L-Sn63Ag1,5

#### Verarbeitungsbedingungen:

**Substrate:** AlN-ANCeram

**Drucken:** 200 mesh Edelstahlsieb mit  
10-12 µm Emulsion.  
Nivellieren bei Raumtemperatur 10 min.  
Trocknen bei 150°C, 15-20 min.

**Einbrand:** In Luft, Peaktemperatur: 850°C.  
Zeit bei Peaktemperatur: 10 min.  
Zykluszeit: 60 min.

**Lagerung:** Pasten kühl bei 4 - 10°C lagern.  
Behälter erst nach Erreichen der  
Raumtemperatur öffnen.  
Vor der Anwendung Paste sorgfältig  
mischen.

**Verdüner:** FK 100